VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENABBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

WIPO

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

·				
Aktenzeichen des Anmeiders oder Anwalts 21.725 TE/ps WEITERES VORGEHI		siehe Formblatt PCT/IPEA/416		
Internationales Aktenzeichen Internationales Anmeldec		•		
PCT/DE2004/001361 28.06.2004		30.07.2003		
Internationale Patentidassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H01L23/427, H01L23/473, H05K7/20				
Anmelder KERMI GMBH et al.				
 Bei diesem Bericht handelt es sich um den Internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird. 				
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 4 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.				
3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen				
a. 🛛 (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt 5 Blätter; dabei handelt es sich um				
Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).				
Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.				
b. (nur an das Internationale Büro gesandt)i> insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).				
4. Dieser Bericht enthält Angaben z	u folgenden Punkten:			
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │	Bescheids			
☐ Feld Nr. II Priorität				
☐ Feld Nr. III Keine Erstellur Anwendbarkei	g eines Gutachtens über Ne	uheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche		
☐ Feld Nr. IV MangeInde Eir	heitlichkeit der Erfindung			
☐ Feld Nr. V Begründete Feund der gewer	ststellung nach Arikel 35(2) h blichen Anwendbarkeit; Unte	ninsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit rlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung		
☐ Feld Nr. VI Bestimmte and	jeführte Unterlagen			
☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mä	ngel der internationalen Anm	eldung		
☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Be	merkungen zur internationale	n Anmeldung		
Datum der Einreichung des Antrags	Da	tum der Fertigstellung dieses Berichts		
27.05.2005	31	.10.2005		
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung		vollmächtigter Bediensteter		
beauftragten Behörde Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523	3656 epmu d	dmeades, M		
Fax: +49 89 2399 - 4465		1. +49 89 2399-2731		

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2004/001361

_		
	Feld Nr. I	Grundlage des Berichts
	Hinsichtlich eingereicht	der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
	bei dei □ inte □ Vei	ericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: ernationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) öffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) ernationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)
2.	Anmeldear	der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblätter, die dem int auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als ch eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt):
	Beschreibung, Seiten	
	1-19	in der ursprünglich eingereichten Fassung
Ansprüche, Nr.		
	1-13	eingegangen am 27.05.2005 mit Schreiben vom 20.05.2005
Zeichnungen, Blätter		
	1-5	in der ursprünglich eingereichten Fassung
	□ einem Sequenzp	s Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das rotokoll
3	☐ Be 図 Ar ☐ Ze ☐ Se	und der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: eschreibung: Seite esprüche: Nr. 14-16 eichnungen: Blatt/Abb. equenzprotokoll <i>(genaue Angaben)</i> : waige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :
4	aufgeliste Auffassun (Regel 70	eschreibung: Seite nsprüche: Nr. eichnungen: Blatt/Abb. equenzprotokoll <i>(genaue Angaben)</i> : waige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :
		Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung t" versehen werden.

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2004/001361

Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Feld Nr. V Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser **Feststellung**

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ansprüche 3,12,13 Ja:

Nein: Ansprüche 1,2,4-11

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ansprüche Ja:

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Nein: Ansprüche 3,12,13 Ja: Ansprüche: 1-13

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

TEIL V

1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: WO02102124 D2: US-A-5982616 D3: US-A-2002021557

2. Aus D1 (siehe Abb.7 in Verbindung mit Abb.1A) ist eine Kühlvorrichtung für ein elektronisches Bauelement mit sämtlichen Merkmalen des Anspruchs 1 bekannt: Bauelement 102; erstes Kühlkörperteil 304,308; zweites Kühlkörperteil 312, Strukturierte Kontaktflächen 108,112, Kanäle 114,316.

Die zusätzlichen Merkmale der Ansprüche 2,4-9 sind ebenfalls aus D1 bekannt.

3. Aus D2 (siehe Abb.2,3) ist eine Kühlvorrichtung für ein elektronisches Bauelement mit sämtlichen Merkmalen des Anspruchs 1 bekannt: Bauelement 24; erstes Kühlkörperteil 76,78,82; zweites Kühlkörperteil 36,40; Kanäle 62, strukturierte Kontaktflächen 70a,82a, Rippen (siehe Abb.5).

Die zusätzlichen Merkmale der Ansprüche 4-11 sind aus D2 bekannt.

- 4. Anspruch 3: Aus D1 geht nicht deutlich hervor, ob das zweite Kühlkörperteil eine Sammelkammer und mehrere verzweigenden Kanäle aufweist. Eine solche Anordnung ist jedoch bereits aus dem Stand der Technik bekannt - siehe D3, [0104] -[0108] und Abb.20-23.
 - Der Fachmann würde daher diese Anordnung in die aus D1 bekannte Vorrichtung übernehmen, um eine verbesserte Kühlkraft zu erzielen.
- 5. Ansprüche 12,13: Aus D1 geht nicht deutlich hervor, wie die einzelnen Elemente des Kühlmediumkreislaufs im Rack integriert werden. Diese Information ist jedoch ohne erfinderische Tätigkeit aus D3 (siehe Abb. 43-46) zu entnehmen.

5

10

15

20

Amtl. Aktenzeichen: PCT/DE2004/001361

Anmelder:

Kermi GmbH

Anwaltsakte:

21.725 TE/ps

Datum:

20. Mai 2005

Patentansprüche

- 1. Kühlvorrichtung für ein elektronisches Bauelement, insbesondere für einen Mikroprozessor,
 - a) mit einem von einem Kühlmedium durchströmbaren Kühlkörper (7, 9), welcher derart mit dem zu kühlenden elektronischen Bauelement (3) verbindbar ist, dass die von dem elektronischen Bauelement (3) erzeugte Verlustwärme über eine thermische Schnittstelle des elektronischen Bauelements auf den Kühlkörper (7, 9) übergeht und abtransportiert wird,
 - b) wobei der Kühlkörper (7, 9) ein erstes Kühlkörperteil (7) umfasst, welches zur Verbindung mit dem elektronischen Bauelement (3) ausgebildet oder mit diesem verbunden ist,
 - c) wobei der Kühlkörper (7, 9) ein zweites Kühlkörperteil (9) umfasst, welches wenigstens einen, von dem flüssigen Kühlmittel durchströmbaren Kanal (15) aufweist,
 - d) wobei am zweiten Kühlkörperteil (9) ein Zulaufanschluss (23) und ein Rücklaufanschluss (25) vorgesehen sind, die mit dem wenigstens einen Kanal (15) verbunden sind,

30

25

5

10

15

e) wobei das zweite Kühlkörperteil (9) lösbar mit dem ersten Kühlkörperteil (7) derart verbunden ist, dass ein geringer Wärmeübergangswiderstand gegeben ist, wobei zumindest der überwiegende Teil der Verlustwärme über das zweite Kühlkörperteil (9) an das Kühlmedium abgegeben wird, und

f) wobei das zweite Kühlkörperteil (9) vom ersten Kühlkörperteil (7) lösbar ist, ohne dass die Verbindung des ersten Kühlkörperteils (7) mit dem elektronischen Bauelement (3) gelöst werden muss,

dadurch gekennzeichnet,

- g) dass das erste Kühlkörperteil (7) eine Kontaktfläche zur thermischen Verbindung mit dem zweiten Kühlkörperteil (9) umfasst, welche eine Struktur (11) zur Vergrößerung der Kontaktfläche aufweist, wobei die Kontaktfläche des ersten Kühlkörperteils (7) mit einer komplementär ausgebildeten Kontaktfläche des zweiten Kühlkörperteils (9) zusammenwirkt,
- 20 h) dass die Strukturen als Rippen (11, 13) ausgebildet sind, wobei zumindest in den Rippen (13) des zweiten Kühlkörperteils (9) Kanäle (15) für das Kühlmedium vorgesehen sind.
- 2. Kühlvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Rippen schräge, ebene Flanken und vorzugsweise einen trapezförmigen Querschnitt aufweisen.

5

10

15

- 3. Kühlvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Kühlkörperteil (9) im Bereich des Zulaufanschlusses (23) und/oder des Rücklaufanschlusses (25) eine Sammelkammer aufweist, von der aus sich mehrere Kanäle (15) für das Kühlmedium verzweigen oder in diese münden.
- 4. Kühlvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Kühlkörperteil (9) in zumindest einer Richtung bezogen auf die Kontaktfläche mit dem ersten Kühlkörperteil (7) größere Abmessungen als das erste Kühlkörperteil (7) aufweist und dass das zweite Kühlkörperteil (9) so ausgebildet ist, dass mittels des Kühlmitteldurchflusses durch den wenigstens einen Kanal (15) in der Kontaktfläche mit dem ersten Kühlkörperteil eine bezogen auf die Kontaktfläche im Wesentlichen gleichmäßige Wärmeableitung möglich ist.
 - 5. Kühlvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Kühlkörperteil (7) als Heatpipe ausgebildet ist.
- 20 6. Kühlvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Befestigungseinrichtung vorgesehen ist, welche Mittel zum vorzugsweise lösbaren Verbinden des ersten Kühlkörperteils (7) mit dem zu kühlenden elektronischen Bauelement (3) umfasst.
- 7. Kühlvorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungseinrichtung weitere Mittel zum lösbaren Verbinden des zweiten Kühlkörperteils (9) mit dem ersten Kühlkörperteil (7) umfasst, wobei bei einem Lösen des zweiten Kühlkörperteils (9) vom ersten Kühlkörperteil

·5·

10

15

20

25

- (7) das erste Kühlkörperteil (7) mit dem elektronischen Bauelement (3) verbunden bleibt.
- 8. Rack zur Aufnahme mehrerer Elektronikkomponenten, wie Server für Datenverarbeitungsanlagen,
 - a) wobei auf mehreren Elektronikkomponenten (27) wenigstens ein zu kühlendes elektronisches Bauelement (3) angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet,

- b) dass die zu kühlenden elektronischen Bauelemente (3) jeweils mit einer Kühlvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche ausgerüstet sind, welche als mit einem flüssigen Medium durchströmte Kühlvorrichtungen ausgebildet ist.
- 9. Rack nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die zweiten Kühlkörperteile (9) der Kühlvorrichtungen (1) mit ihren Zulauf- (23) und Rücklaufanschlüssen (25) mit einem oder mehreren zentralen Kühlmittelreservoires oder einem oder mehreren zentralen Wärmetauschern verbunden sind, über welche dem Kühlmedium Wärme entzogen wird.
- 10. Rack nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das eine oder die mehreren zentralen Kühlmittelreservoires oder der eine oder die mehreren zentralen Wärmetauscher im oder am Rack (29) angeordnet sind.
- 11. Rack nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass im Rack (29) ein Leitungssystem vorgesehen ist, welches die Zulaufanschlüsse (23) der

Kühlvorrichtungen (1) mit einem oder mehreren zentralen Zulaufanschlüssen (31) des Racks (29) und die Rücklaufanschlüsse (25) der Kühlvorrichtungen (1) mit einem oder mehreren zentralen Rücklaufanschlüssen (33) des Racks (29) verbindet.

5

·10

12. Rack nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass im Rack (29) wenigstens eine fest im Rack (29) angeordnete, vorzugsweise starre Zulauf-Steigleitung (35) vorgesehen ist, welche mehrere Anschlüsse (39) für vorzugsweise flexible Verbindungsleitungen von jeweils einem Anschluss (39) zu einem Zulaufanschluss (23) eines zweiten Kühlkörperteils (9) einer Kühlvorrichtung (1) aufweist, und dass im Rack (29) wenigstens eine fest im Rack (29) angeordnete, vorzugsweise starre Rücklauf-Steigleitung (37) vorgesehen ist, welche mehrere Anschlüsse (39) für vorzugsweise flexible Verbindungsleitungen von jeweils einem Anschluss (39) zu einem Rücklaufanschluss (25) eines zweiten Kühlkörperteils (9) einer Kühlvorrichtung (1) aufweist.

20

15

13. Rack nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Leitungssystem eine Zulaufsteigleitung und eine Rücklaufsteigleitung sowie eine mit der Rücklaufsteigleitung verbundene Abführleitung umfasst, wobei die Durchströmungslängen aller angeschlossenen Kühlvorrichtungen zumindest annähernd gleich sind, wobei sich die Durchströmungslängen aus den Teillängen der jeweils von der betreffenden Teilströmung der jeweiligen Kühlvorrichtung genutzten Längen der Zulaufsteigleitung und der Rücklaufsteigleitung ergeben.

25